

(端子部有切槽)

( $\phi 0.85$ )

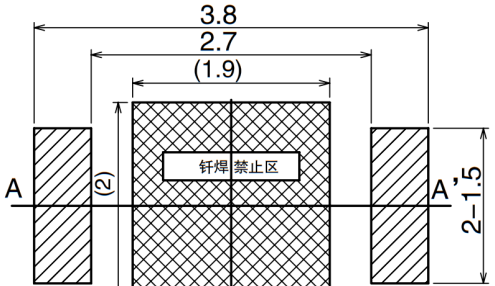
0.1max.

0.1max.

A O — O — O A'

电路图

焊锡模板厚度为0.08mm  
开口率为焊盘图案的60%~100%。  
(推荐80%)



印刷电路板焊盘参考图

\* 焊锡涂层不均会导致封装钎焊失败，  
因此请使用推荐焊锡层和焊盘图案。

推荐焊盘图案区  
钎焊禁止区

请勿在 区域配置焊盘图案和过孔。  
需配置焊盘图案或过孔时，为避免金属部分外露，  
请进行绝缘涂层和抗蚀剂等处理。  
金属部分外露，可能会因焊锡球导致与开关背面  
端子部之间短路。  
此外，铜箔厚度和图案布局产生的凹凸差，会对开关  
的倾斜和与焊锡的接合状态、助焊剂渗透造成影响。  
因此，请在使用前进行验证。

SPECIFICATIONS

- Operating temperature range:  $-30^{\circ}\text{C}$  to  $85^{\circ}\text{C}$
- Rating: DC12V 50mA
- Insulation resistance:  $100\text{M}\Omega$  min 100V DC
- Dielectric strength: 250V AC for 1min.
- Contact resistance:  $500\text{m}\Omega$  Max
- Operating force:  $320\pm 30\text{gf}$
- Travel:  $0.15\pm 0.05\text{mm}$
- Operating life: 3,00000Cycle

浇口(连接处)切断残留除外

0.6±0.1  
(0.385)

单位 UNIT		一般公差 GENERAL TOLERANCE		深圳市韩下电子有限公司 HANXIA		
制图 DRAW		mm				
设计 DESIGN				.X±0.5	ANGLES	名称 TITLE
				.XX±0.2	X.'±5'	
				.XXX±0.1	X.'±2'	
审核 CHECKED	张伟			材质 MATERIAL		型号 MODEL
校准化 STANDARD				重量 WT.		图号 DWG NO.
批准 APPROVE	罗小春			表面积 SA.		角法 PROJ.

比例 SCALE	10: 1	版本 REV.	A0	张数 SHEET	第1页共1页
-------------	-------	------------	----	-------------	--------